

Title (en)
Connecting device

Title (de)
VerbindungsVorrichtung

Title (fr)
Dispositif de connexion

Publication
EP 2337154 A1 20110622 (DE)

Application
EP 10014755 A 20101118

Priority
DE 202009016970 U 20091216

Abstract (en)
The device (1) has a crimping sleeve (5) including a sleeve cavity (6) through which a conductor (35) of a shielded line (2) is arranged in a housing interior (4) in a conductible manner. A conductor shield (8) of the line is fastenable at a free end section (9) by crimping relative to the crimping sleeve and in shield contact with the housing, where the crimping sleeve has a radially outwardly projecting sealing projection (11). The conductor shield is passed through the sleeve cavity with a crimping section of the end section.

Abstract (de)
Bei einer VerbindungsVorrichtung zur Verbindung einer geschirmten Leitung mit einem Gehäuse ist die Leitung im Gehäuseinneren elektrisch kontaktierbar. Dabei weist die VerbindungsVorrichtung wenigstens eine Crimphülse auf, durch deren Hülsenhohlraum zumindest ein Leiter der Leitung bis ins Gehäuseinnere führbar angeordnet ist. Eine Leiterabschirmung der Leitung ist an einem freien Endabschnitt durch Crimpen relativ zur Crimphülse befestigbar und mit dem Gehäuse in Abschirmungskontakt. Erfindungsgemäß ist die entsprechende Leiterabschirmung in einfacher Weise mit dem Gehäuse verbunden, so dass ein entsprechender Abschirmungskontakt zwischen Gehäuse und Leiterabschirmung gegeben ist. Dadurch können Leiterabschirmung und Gehäuse insgesamt als Abschirmung betrachtet werden. Es ergibt sich eine gute elektrische und elektronische Störfreiheit von entsprechenden Einrichtungen innerhalb des Gehäuses sowie der entsprechenden VerbindungsVorrichtung gegenüber der Umwelt, siehe EMV.

IPC 8 full level
H01R 9/05 (2006.01); **H01R 13/52** (2006.01); **H01R 13/658** (2011.01)

CPC (source: EP US)
H01R 9/0518 (2013.01 - EP US); **H01R 13/5202** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6584** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6588** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6593** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 2008119088 A1 20080522 - NOH YONG-JOON [KR], et al
- [X] DE 19848343 A1 19990429 - YAZAKI CORP [JP]
- [I] EP 1237237 A2 20020904 - YAZAKI CORP [JP]
- [X] US 2002094724 A1 20020718 - SAITO SATOSHI [JP], et al
- [X] DE 10349583 A1 20040519 - HITACHI CABLE [JP]

Citation (examination)

- EP 2055535 A1 20090506 - LEONI BORDNETZ SYS GMBH [DE]
- GB 2348746 A 20001011 - YAZAKI CORP [JP]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
DE 202009016970 U1 20110428; CN 102104241 A 20110622; EP 2337154 A1 20110622; US 2011143589 A1 20110616; US 8118613 B2 20120221

DOCDB simple family (application)
DE 202009016970 U 20091216; CN 201010589294 A 20101210; EP 10014755 A 20101118; US 96846210 A 20101215